

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

编号：2025-007

长沙景嘉微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	中泰证券、华创证券、浙商证券、东北证券、华西证券、国信证券、中金公司、汇添富基金、南方基金、易方达基金、混沌投资、富国基金、东吴基金、新华基金、兴证全球、申万菱信、银华基金、鹏华基金、景顺长城、天弘基金、诺德基金、华夏财富、创金合信、太平养老保险、太平资产、泰康人寿、华宝基金、中金资管、民生加银、中信保诚、永安国富、富荣基金、方圆基金、国投瑞银、国寿资产、高毅资产等 106 家机构共 132 位投资者。 (排名不分先后)
时间	2025 年 12 月 15 日-16 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总裁 董事会秘书周振武
投资者关系活动主要内容介绍	一、诚恒微边缘侧 AI SoC 芯片 CH37 系列基本情况 诚恒微把握人工智能产业创新发展机遇，锚定边缘侧算力引擎，专注提供高端主控智算处理器与高能效智能感知平台，推动智能机器从“功能执行”向“自主进化”跃升。诚恒微的业务涵盖了集成电路设计前沿研发、芯片架构设计、配套软件开发及行业解决方案赋能，构建从技术探索到产业落地的全链条能力。 诚恒微自主研发的边缘侧 AI SoC 芯片 CH37 系列，目前已

顺利完成流片、封装、回片及点亮等关键阶段工作。经测试，其基本功能与核心性能指标(包括算力效率、模块协同及稳定性等)均已达到设计要求。

诚恒微边端侧 AI SoC 芯片 CH37 系列，基于自主研发架构，采用高集成度的单芯片设计，集成了高端 CPU、GPU、NPU、GPGPU、ISP 等高规格处理单元，具有充沛的 AI 算力、灵活计算精度、高实时、低延迟以及高效多传感处理等性能优势。

二、座谈交流环节

1、诚恒微边端侧 AI SoC 芯片 CH37 系列有哪些特点？

诚恒微边端侧 AI SoC 芯片 CH37 系列的主要性能特点有：

高集成：CH37 系列单芯片集成了高端 CPU、GPU、NPU、GPGPU、ISP 等高规格处理单元。

算力充沛：CH37 系列提供 64TOPS@INT8 的峰值 AI 算力，为复杂的视觉识别、多模态感知与决策模型在端侧实时运行中提供计算动力。

低功耗：CH37 系列在保障算力的同时，实现了较低的功耗控制。

应用场景广：面向算力需求较高的具身智能与边缘计算等通用市场，可以涵盖包括但不限于机器人、AI 盒子、智能终端、智能识别、无人机吊舱等多种场景。

2、诚恒微边端侧 AI SoC 芯片 CH37 系列在算力、功耗等参数方面，与市面上的竞品相比，处于什么水平？

诚恒微边端侧 AI SoC 芯片 CH37 系列与市场现有竞品相比，其在算力、功耗等关键指标上表现卓越。CH37 系列可提供 64TOPS@INT8 的峰值计算能力，在确保高性能的同时，将功耗维持在较低水平。在算力达到高水平的同时，功耗得到了稳定控制，实现了出色的能效比。

未来，将持续优化芯片架构设计，进一步提升能效比与算力密度，力争在下一代产品中实现更高性能与更低功耗的协同突破，巩固国产 AI 芯片在边缘计算领域的竞争力。

3、诚恒微边缘侧 AI SoC 芯片 CH37 系列有哪些竞争优势？

高性能集成芯片架构：运用高集成度单芯片设计，整合了高端 CPU、GPU、NPU 等多种高规格处理单元，具备强大算力、灵活精度、低延迟的特性，面向具身智能、边缘计算等前沿领域。

双模 ISP 强适配：独具特色的双模融合 ISP 技术，支持可见光与红外双路独立处理，在多传感融合和能效比方面表现卓越，形成了鲜明的技术差异化，能够更出色地满足复杂场景下的智能感知需求。

广泛覆盖通用市场：诚恒微聚焦于边缘侧算力引擎，针对具身智能与边缘计算等对算力要求较高的通用市场，其应用范围能够覆盖包括但不限于机器人、AI 盒子、智能终端、智能识别、无人机吊舱等多种场景。诚恒微可提供单芯片解决方案，在降低成本的同时提升部署效率。

4、预计该款芯片量产及后续向市场导入的节奏？

诚恒微这款芯片在本次点亮过程中总体较为顺利，再次彰显了研发团队深厚的研发实力。后续将逐步完成新产品全方位测试和导入工作，积极与机器人、AI 盒子、智能终端等领域的客户进行沟通与交流，推动其实现规模化商业落地。

5、客户侧对于边缘侧芯片的需求点聚焦在什么方面？

客户需求主要聚焦在三个维度：

算力性能持续提升：随着智能终端设备的普及和算力需求的提升，将 AI 能力下沉至终端设备已成为行业共识，客户对算力的需求持续攀升。CH37 系列提供高达 64TOPS@INT8 的峰值计

	<p>算能力，充分满足客户对算力日益增长的需求。</p> <p>功耗控制要求严苛：部分应用场景对功耗指标要求极为严格，需在算力与能效之间实现精准平衡。</p> <p>接口配置丰富灵活：CH37 系列作为通用型芯片解决方案，其集成的 ISP 支持可见光与红外双模成像，可适配多样化特定场景需求。</p>
6、公司目前与诚恒微团队的合作情况如何？	<p>当前，景嘉微持续吸纳优秀研发人才，同时按计划推进募投项目“高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目”及“通用 GPU 先进架构研发中心建设项目”的实施工作。公司正着力优化以“GPU+边缘侧 AI SoC 芯片”为核心的产品矩阵，不断提升核心竞争力与市场影响力。</p> <p>未来，景嘉微将充分发挥协同效应，促使边缘侧 AI SoC 芯片与景嘉微 GPU 构建起“云-边-端”算力闭环。景嘉微与诚恒微的研发团队将携手共进，通过持续推动芯片迭代优化以及生态体系建设，加速在具身智能、边缘计算等前沿场景的实际应用，助力打造具备安全可控性能的国产化算力底座。</p>
附件清单(如有)	
日期	2025 年 12 月 16 日